

ニュースガイドNo, 11002

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中！ <http://www.itdc-patent.com>

\*最新の特許情報が満載！

## 無電解貴金属メッキ方法と工程

[公開編]平成26年(1年間) 70点

	(税込価格)	(本体価格)
全文PDF CD-ROM版(抄録版付)	¥21,600-	¥20,000-
全文紙収録 B5製本版	¥21,600-	¥20,000-
CD-ROM版・B5製本版 一括購入	¥32,400-	¥30,000-

### 既刊関連セットのご案内

No.	公開特許	無電解貴金属メッキ方法と工程	平.	点	(本体価格)
No,10891	公開特許	無電解貴金属メッキ方法と工程	平.25	70点	¥20,000
No,10830	"	"	平.24	70点	¥20,000
No,10700	"	"	平.23	59点	¥18,000
No,10579	"	"	平.22	59点	¥18,000
No,10493B	"	"	平.21	60点	¥18,000
No,10493A	"	"	平.20	60点	¥18,000
No,10201B	"	"	平.19	66点	¥23,100
No,10201A	"	"	平.18	66点	¥23,100
No,9997C	"	"	平.17	84点	¥18,600
No,9997B	"	"	平.16	65点	¥19,200
No,8537	"	無電解ニッケルメッキ方法と浴の組成	平.7-平.9	65点	¥28,000
No,10199	"	無電解スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.15-平.19	62点	¥24,885
No,9998	"	スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.13-平.17	100点	¥29,600
No,9189	"	"	平.10-平.12	68点	¥24,800
No,9088	"	硫酸銅メッキ方法と浴の組成	平.5-平.12	71点	¥27,700
No,9086	"	銅めっき装置の構造と付属装置	平.5-平.12	70点	¥27,400
No,9087	"	プリント基板のメッキ処理装置	平.8-平.12	71点	¥27,700
No,8929	"	メッキ前処理剤の組成と前処理方法	平.5-平.11	81点	¥31,600
No,8926	"	半田メッキ方法と工程	平.5-平.11	75点	¥29,700
No,9190	"	銀合金メッキ方法と浴の組成	平.5-平.12	68点	¥24,700

\*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: [kokusai@itdc-patent.com](mailto:kokusai@itdc-patent.com))

お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしおりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。

2～3日中に請求書同封の上お送り致します。]

### お 申 込 書

会社名	ご注文内容	
	ニュースガイドNo.	
	CD-ROM版 or B5製本版 or 一括購入	
所属部署名	題名	
		合計 ¥
担当者名	E-mail:	
	TEL:	FAX:
住所:〒		

料金には別途送料がかかります。

# 無電解貴金属メッキ方法と工程

No.11002

[公開編] 平成26年(1年間) 70点

CD-ROM版 ¥21,600 B5製本版 ¥21,600 (全て税込価格)

( CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥32,400 )

- |    |  |  |    |  |  |
|----|--|--|----|--|--|
| 1  | 金属材料と樹脂材料との接合体、その製造に用いる樹脂材料接合用金属材料の製造方法及びその接合体...  | 株式会社豊田中央研究所                            | 31 | 非磁性体からなる中間層上に形成された薄膜                     | 太陽化学工業株式会社                             |
| 2  | 紙への無電解めっき前処理方法および無電解めっき方法                          | 福井県                                    | 32 | プリント配線基板の製造方法およびその方法により製造されたプリント配線基板     | 上村工業株式会社                               |
| 3  | ノーシアン無電解金めっき浴                                      | 学校法人関東学院                               | 33 | ガラスメッキ方法                                 | マフレン株式会社                               |
| 4  | 金属めっき皮膜を有する半導体基材およびその製造方法                          | 国立大学法人福井大学                             | 34 | 配線基板の製造方法                                | セイコーエプソン株式会社                           |
| 5  | 金属層がめっきされた絶縁基材及びそのめっき方法、並びにこれを用いた透明電極              | サムソン エレクトロメカニクス カンパニーリミテッド             | 35 | 被覆体及び電子部品                                | TDK株式会社                                |
| 6  | マスキング剤および表面処理基材の製造方法                               | JEインターナショナル株式会社                        | 36 | 無電解めっき下地膜形成用組成物                          | 出光興産株式会社                               |
| 7  | ビルドアップ積層基板の製造方法                                    | 上村工業株式会社                               | 37 | 基材上で付着金属をパターン化する方法                       | スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー             |
| 8  | 印刷回路基板の製造方法  | サムソン エレクトロメカニクス カンパニーリミテッド             | 38 | 無電解めっき物の製造方法                             | 出光興産株式会社                               |
| 9  | 表面処理装置   | 上村工業株式会社                               | 39 | 無電解めっき用のセンシタイジング液および無電解めっき方法             | 長野県                                    |
| 10 | 表面処理浴管理方法  | 株式会社三協                                 | 40 | 圧電素子の製造方法及び液体噴射ヘッドの製造方法                  | セイコーエプソン株式会社                           |
| 11 | 金属多孔体の製造方法   | 地方独立行政法人 大阪市立工業研究所                     | 41 | 無電解ニッケルおよび金めっきするための銀ペースト組成物              | イー・アイ・デュボン・ドウ・ヌムール・アンド・カンパニー           |
| 12 | 回路基板及びその製造方法                                       | サムソン エレクトロメカニクス カンパニーリミテッド             | 42 | スクリーン印刷用触媒インク                            | 日産化学工業株式会社                             |
| 13 | 表面光輝品の製造方法   | 三恵技研工業株式会社                             | 43 | 導電性基板の面への金属イオンの析出                        | ディーエフエイチエス, エルエルシー                     |
| 14 | 自己触媒型無電解銀めっき液及びめっき方法                               | 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社             | 44 | めっき触媒および方法                               | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル.エル.シー. |
| 15 | 低遊離シアン金塩の製造方法                                      | 小島化学薬品株式会社                             | 45 | 液体噴射ヘッド、液体噴射装置、圧電素子及びその製造方法              | セイコーエプソン株式会社                           |
| 16 | 金薄膜形成方法及び印刷回路基板                                    | サムソン エレクトロメカニクス カンパニーリミテッド             | 46 | 有機電子デバイス                                 | ケンブリッジ ディスプレイテクノロジー リミテッド              |
| 17 | 二次電池用集電体、その製造方法、及び二次電池                             | 株式会社豊田自動織機                             | 47 | 液体噴射ヘッド、液体噴射装置、圧電素子及びその製造方法              | セイコーエプソン株式会社                           |
| 18 | 電極パッド、これを用いた印刷回路基板及びその製造方法                         | サムソン エレクトロメカニクス カンパニーリミテッド             | 48 | 無電解パラジウムめっき又は無電解パラジウム合金めっきの前処理用活性化液      | 奥野製薬工業株式会社                             |
| 19 | 銀メッキ塗装体  | 三菱製紙株式会社                               | 49 | 金属部品の製造方法並びにこれに用いられる鋳型および離型膜             | 富士フィルム株式会社                             |
| 20 | 無電解めっき用塗料組成物                                       | 株式会社イオックス                              | 50 | 電気回路配線基板の製造方法                            | 富士フィルム株式会社                             |
| 21 | 複合めっき材、その製造方法、電気・電子部品、および嵌合型の端子・コネクタ、摺動型や回転型の接点... | 古河電気工業株式会社                             | 51 | めっき下地用塗料、当該塗料を用いためっき下地塗膜層の製造方法、めっき物の製造方法 | 三菱レイヨン株式会社                             |
| 22 | 無電解金属化のための方法                                       | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル.エル.シー. | 52 | めっき物                                     | JX日鉱日石金属株式会社                           |
| 23 | 無電解めっき方法及び無電解めっき膜                                  | 学校法人関東学院                               | 53 | 金属膜形成方法および前記方法に用いる導電性インク                 | JSR株式会社                                |
| 24 | 無電解めっき用バスケットジグ及びこれを用いるメッキ方法                        | サムソン エレクトロメカニクス カンパニーリミテッド             | 54 | 無電解めっき層の形成方法                             | 三共化成株式会社                               |
| 25 | LED用ウエハおよびその製造方法                                   | 株式会社高松メッキ                              | 55 | 無電解めっき方法、及び無電解めっき装置                      | 三友セミコンエンジニアリング株式会社                     |
| 26 | 表面処理装置   | 上村工業株式会社                               | 56 | 銀メッキ構造体                                  | カヤバ工業株式会社                              |
| 27 | 無電解めっきのための方法およびそのために使用される溶液                        | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル.エル.シー. | 57 | 電磁波透過性材料                                 | 三恵技研工業株式会社                             |
| 28 | パターン化されためっき物                                       | アキレス株式会社                               | 58 | 無電解めっき層の形成方法                             | 三共化成株式会社                               |
| 29 | 金含有溶液中の金濃度の定量方法、および金濃度定量装置                         | 上村工業株式会社                               | 59 | 無電解めっき方法、多層基材の製造方法、多層基材および入力装置           | 日東電工株式会社                               |
| 30 | 銀めっき塗装体  | 三菱製紙株式会社                               |    |  | 以下11点省略                                |